



ELKEM
VI RIDUCE
TEMPI, INGOMBRI
E SCARTI ...

Rev.1 05/2004 1

ELKEM S.R.L. CHEMICALS FOR PCB ASSEMBLING

Strada Banchette,1 10090 Rosta (TO) ITALY • T:+39 011 9540103/ 9542716 • F: +39 011 9597182 •



- Flussanti per saldatura ad onda
 - Alcolici
 - VOC free (100 % acquosi)
 - Flussanti per saldatura leadfree
- Barre Stagno Piombo 63/37 e leadfree
- Sali per riduzione scorie nel pozzetto di saldatura
- Nastri in Kapton per mascheratura
- Kapton dots
- Protettivi spellicolabili temporanei, con e senza ammoniaca, applicabili manualmente, per serigrafia o a dispensazione

- Paste saldanti convenzionali e senza piombo
- Fili saldanti Stagno Piombo 60/40 e leadfree
- Adesivi per SMT
- Solventi per pulizia schede
- Solventi per pulizia telai da paste saldanti ed adesivi. Pulizia manuale o in macchine automatiche
- Rotoli per pulizia stencil con macchine automatiche : materiale Sontara CleanMaster.
- Salviette asciutte e presaturate per ogni applicazione
- Splicing kits & splicing tapes.

- Moduli per pulizia stencil e circuiti stampati dopo errore di stampa
- Prodotti per la riparazione : fili saldanti, flux remover, trecce dissaldanti
- Macchine per produzione SMT a livello prototipi e piccole serie :
 - Serigrafiche
 - pick & place semi-automatiche ed automatiche
 - forni da rifusione (già compatibile con leghe senza Piombo).

Rev.1 05/2004 2

ELKEM S.R.L. CHEMICALS FOR PCB ASSEMBLING

Strada Banchette,1 10090 Rosta (TO) ITALY • T:+39 011 9540103/ 9542716 • F: +39 011 9597182 •



Paste saldanti No Clean Convenzionali

E-K 809 T3

- Sn₆₂Pb₃₆Ag₂ / Sn₆₃Pb₃₇
- Elevata finestra operativa
- Fino a 0,3 mm
- Elevato tack life
- Ampia finestra di rifusione
- Eccellente bagnabilità su tutti tipi di finitura
- Senza alogeni
- Elevata resistenza d'isolamento e assenza totale d'elettro-migrazione

LEAD FREE

E-K SOLDER PASTE 70 PLF

- Sn 96.5 / Ag 3.0 / Cu 0.5 / Ni 0.06 / Ge 0.01

Rivoluzionaria lega a 5 elementi.

L'aggiunta di una piccola percentuale di Nichel incrementa la resistenza della giunzione di saldatura; l'aggiunta di una piccolissima percentuale di Germanio previene la naturale tendenza all'ossidazione dello Stagno e incrementa la bagnabilità.

- Eccellente stampabilità e bagnabilità
- Senza alogeni
- Deboli residui

Rev.1 05/2004 3

ELKEM S.R.L. CHEMICALS FOR PCB ASSEMBLING

Strada Banchette,1 10090 Rosta (TO) ITALY • T:+39 011 9540103/ 9542716 • F: +39 011 9597182 •



Alloy Composition	Melting point	Products				Gravity	Strength (kgf/mm)	Elongation (%)	Remark
		Bar	Ball	Wire	Paste				
Sn-Bi58	138 °C	☐	☐	☐	☐	8.56	7.80	27	Low Temperature alloy
Sn-Ag3.5	221 °C	☐	☐	☐	☐	7.36	4.18	58	Soldering rework use
Sn-Cu0.7	227 °C	☐	☐	☐	☐	7.32	3.80	50	Wave soldering & rework
Sn99.95	232 °C	☐	☐	☐	☐	7.28	2.20	55	Medium temperature alloy
Sn-Ag3.0-Cu0.5-Ni0.06-Ge0.01	219 °C	☐	☐	☐	☐	7.4	5.40	48	Medium temperature alloy

E-K SOLDER PASTE 70 PLF	
Composizione lega	Sn-Ag3.0-Cu0.5-Ni0.06-Ge0.01
Tipologia flussante	RMA
Dimensione particelle (µm)	20-45
Contenuto flussante (wt%)	11.0 ± 0.5
Contenuto alogenuri(wt%)	0.05
Viscosità (Pa.s)	200 ± 50

Rev.1 05/2004 4

ELKEM S.R.L. CHEMICALS FOR PCB ASSEMBLING

Strada Banchette,1 10090 Rosta (TO) ITALY • T:+39 011 9540103/ 9542716 • F: +39 011 9597182 •



Flussante a base alcoolica

E-K FLUX 121.9

- Applicabile per **spray, schiuma o ad immersione**
- 1,9 % di solidi. Valore di acidità : 14
- Assenza di residui
- Senza alogenuri
- Assenza del solderballing
- Eccellente saldabilità
- Non provoca falsi contatti
- Compatibile con le maschere di saldatura sul mercato
- Non necessita di lavaggio

E-K FLUX 3592

- Applicabile per **spray, schiuma o ad immersione**
- 3 % di solidi. Valore di acidità : 22
- Assenza di residui
- Senza alogenuri
- Assenza del solderballing
- Eccellente saldabilità
- Non provoca falsi contatti
- Compatibile con le maschere di saldatura presenti sul mercato
- Non necessita di lavaggio

E-K FLUX 324.0

- Applicabile per **spray, schiuma o ad immersione**
- **Formulato per macchine con pre-riscaldamento ridotto**
- 4 % di solidi. Valore di acidità : 23
- Assenza di residui
- Senza alogenuri
- Assenza del solderballing
- Eccellente saldabilità
- Non provoca falsi contatti
- Compatibile con le maschere di saldatura presenti sul mercato

Rev.1 05/2004 5

ELKEM S.R.L. CHEMICALS FOR PCB ASSEMBLING

Strada Banchette,1 10090 Rosta (TO) ITALY • T:+39 011 9540103/ 9542716 • F: +39 011 9597182 •



- Non necessita di lavaggio

Flussante a base acquosa

E-K FLUX 501 W

- Senza componenti organici volatili
- Applicabile per spray
- 4 % di solidi . Valore di acidità : 40.
- Senza alogenuri
- Non necessita di lavaggio
- Saldature brillanti

Rev.1 05/2004 6

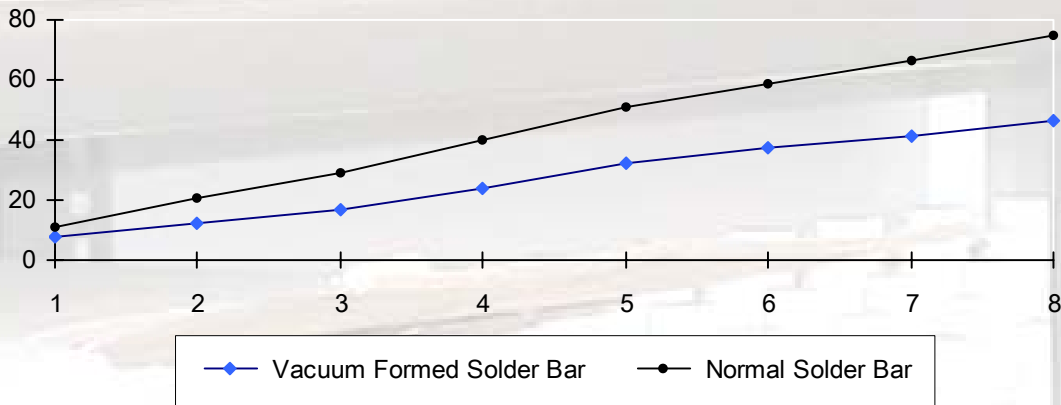
ELKEM S.R.L. CHEMICALS FOR PCB ASSEMBLING

Strada Banchette,1 10090 Rosta (TO) ITALY • T:+39 011 9540103/ 9542716 • F: +39 011 9597182 •



Barre Stagno Piombo

- Sn63Pb37 e leghe senza piombo
- Stagnatura regolare ed omogenea
- Diminuzione delle scorie



Rev.1 05/2004 7

ELKEM S.R.L. CHEMICALS FOR PCB ASSEMBLING

Strada Banchette,1 10090 Rosta (TO) ITALY • T:+39 011 9540103/ 9542716 • F: +39 011 9597182 •



E-K COVER MASK

- Agente di mascheratura per saldature
- Prodotto a bassa viscosità
- Scarso odore
- Protegge i circuiti stampati, i fori metallizzati, i contatti
- Protegge a breve termine dalle alte temperature fino a 268°C
- Non infiammabile
- Asciugatura rapida



QTEK SONTARA® CLEAN MASTER Du Pont

- Rulli d'asciugatura automatica degli stencil in sistemi standard o sotto vuoto per macchine serigrafiche.
- Assicura un lavaggio perfetto
- Non lascia residui
- Non si strappa
- Resiste alle deformazioni d'allungamento
- Assorbimento fino a 6 volte il suo peso in acqua
- Assicura un'asciugatura efficace e rapida
- Compatibile con tutte le serigrafiche attualmente in commercio

Rev.1 05/2004 8

ELKEM S.R.L. CHEMICALS FOR PCB ASSEMBLING

Strada Banchette,1 10090 Rosta (TO) ITALY • T:+39 011 9540103/ 9542716 • F: +39 011 9597182 •



Product comparison between Sontara® CleanMaster 8838 and Competition (Airlaid Under Screen Cleaning Fabric)

Property	Unit	Sontara® CleanMaster	Competition	Test Method
Style 8838 (Airlaid Under Screen Cleaning Fabric)				
Basic weight	g/m ²	52.4	46.1	ERT 40.3-90
Thickness	mm	0.28	0.37	ERT 30.5-99
Burst Strength	kPa	481	248	ENISO 13938-1
Absorbency	%	508	305	ERT 10.3-99
Absorbency Capacity	ml/m ²	267	136	IST 10.2-98
Absorbency Rate (with water)	ml/g/s	30.0	13.3	IST 10.2-98
Tensile Strength (dry)	MD	N	63.7	ASTM D5034
	XD	N	115.8	
Abrasion, dry		10.2	14.2	ASTM D3884
Abrasion, wet		9.6	15.0	

Rev.1 05/2004 9

ELKEM S.R.L. CHEMICALS FOR PCB ASSEMBLING

Strada Banchette,1 10090 Rosta (TO) ITALY • T:+39 011 9540103/ 9542716 • F: +39 011 9597182 •



Solvente E-K SCS/2

- Per lavaggi manuali di paste saldanti ed adesivi(adesivi non polimerizzati, telai serigrafici, errori di stampa).
- Evaporazione relativamente rapida
- Bassa viscosità
- Debole emissione alle temperature d'impiego

Solvente E-K MG 600

- Per lavaggio degli stencil e delle schede da paste saldanti
- Flash point elevato
- Debole emissione alle temperature d'impiego
- Odore ridotto

E-K STENCIL WASH

- Per lavaggio stencil da paste saldanti, sia manuale che su moduli in automatico (lavatrici)
- Confezioni da 1 lt spray , 5 lt o 25 lt
- Prodotto 100 % acquoso
- Ecologico

STENCIL CLEAN QTEK: Salviette pre - saturate

- Salviette saturate con liquidi a forte potere sgrassante per pulizia stencil e schede da paste saldanti
- Confezione da 100 pezzi, lint free
- Confezione con apertura a molla che garantisce sempre la chiusura completa del contenitore
- Disponibili le ricariche da 100 pezzi

Rev.1 05/2004 10

ELKEM S.R.L. CHEMICALS FOR PCB ASSEMBLING

Strada Banchette,1 10090 Rosta (TO) ITALY • T:+39 011 9540103/ 9542716 • F: +39 011 9597182 •



- Assicura un lavaggio rapido ed efficace
- Non si strappa
- Asciugatura rapida

SMT WIPES

Part No.	Descrizione	Misure standard
QTEK 5709	SMT Wipe	9" x 9"
QTEK 5909	Cleanroom Wipe	9" x 9"
QTEK 5512	Industrial Wipe	12" x 12"

- Salviette fabbricate in tessuto non-tessuto altamente assorbente, per la rimozione efficace di contaminanti. Compatibile con qualsiasi tipo di chimica, presentano eccellenti caratteristiche di bagnabilità.



Rev.1 05/2004 11

ELKEM S.R.L. CHEMICALS FOR PCB ASSEMBLING

Strada Banchette,1 10090 Rosta (TO) ITALY • T:+39 011 9540103/ 9542716 • F: +39 011 9597182 •



FILI SALDANTI

E-K F2

- Filo animato a tre anime di flussante per saldatura destinato ai settori elettromeccanico ed elettronico.
- La colofonia contenuta, normalmente al 2,2% del peso del prodotto finito (attivata con prodotti chimici organici cloridrati) è conforme alle norme QQ-S 571C e DIN 8511F - SW 26. Il residuo si neutralizza alle temperature di saldatura e pertanto non è corrosivo; su zone fredde può permanere una corrosività residua. In questi casi si consiglia il lavaggio in acqua.

<u>Composizione chimica</u>	<u>Contenuto %</u>
Sn	59 - 61
Sb	0.15
Cu	0.03
Fe	0.03
Bi	0.05
Pb	39 - 41

Caratteristiche fisiche

Intervallo di fusione 183° - 188° C.

Il filo viene prodotto nei diametri standard: 0.8 - 3 mm.

- Imballo: In rocchetti da Kg. 0,5 - 3 (Standard)
In scatole di cartone

Rev.1 05/2004 12

ELKEM S.R.L. CHEMICALS FOR PCB ASSEMBLING

Strada Banchette,1 10090 Rosta (TO) ITALY • T:+39 011 9540103/ 9542716 • F: +39 011 9597182 •



E-K "NO - CLEAN "

- Filo animato a tre anime di fluxante per saldatura destinato ai settori elettromeccanico ed elettronico. Consente una saldatura senza lasciare residui visibili..
- Il fluxante contenuto in percentuale del 1,6% circa e' composto da una particolare miscela di attivanti non cloridrati (esenti da alogeni) selezionati per le loro caratteristiche non corrosive. Il residuo si neutralizza alle temperature di saldatura e non dà luogo ad alcun pericolo di corrosione .

Composizione chimica

Contenuto %

Sn	59 - 61
Sb	0.15
Cu	0.03
Fe	0.03
Bi	0.05
Pb	39 - 41

Caratteristiche fisiche

Intervallo di fusione 183° - 188° C.

Il filo viene prodotto nei diametri standard: 0.7 - 3 mm.

- **IMBALLO:**

Rev.1 05/2004 13

ELKEM S.R.L. CHEMICALS FOR PCB ASSEMBLING

Strada Banchette,1 10090 Rosta (TO) ITALY • T:+39 011 9540103/ 9542716 • F: +39 011 9597182 •



In rocchetti da:
In scatole di cartone

Kg. 0,5 - 3 (Standard)

E-K RH60 A

Category	Products Characteristic
Flux Core Solder RH60 A	Mediate active resin core solder wire

2 % DI FLUSSANTE



- Filo Sn/Pb 60/40 con elevata fluidità
- Disponibile anche con diverse leghe lead free: Sn/Cu 0,7 , Lega a 5 elementi (Sn/Ag/Cu/Ni/Ge), Sn/Ag3,5.
- Confezioni da 10 Kg per ogni diametro.

Rev.1 05/2004 14

ELKEM S.R.L. CHEMICALS FOR PCB ASSEMBLING

Strada Banchette,1 10090 Rosta (TO) ITALY • T:+39 011 9540103/ 9542716 • F: +39 011 9597182 •



BLT FLUX REMOVER

- Aerosol da 400 ml
- Fornito con spazzola
- Asciuga rapidamente
- Non lascia residui
- Efficace su tutti i tipi di flussante
- Confezioni da 12 aerosol



TRECCIA DISSALDANTE QTEK (No clean)

- Bobina antistatica
- Larghezza treccia : 0,8-1,5-2,0-2,8-3,7-5,3 mm
- Composizione rame e flussante
- Treccia morbida con speciale conformazione geometrica che permette una dissaldatura :
 - Rapida, pulita, sicura, con un minimo di residui

Rev.1 05/2004 15

ELKEM S.R.L. CHEMICALS FOR PCB ASSEMBLING

Strada Banchette,1 10090 Rosta (TO) ITALY • T:+39 011 9540103/ 9542716 • F: +39 011 9597182 •



NASTRO IN KAPTON EK AB171

Proprietà fisiche

Spessore totale	2.5mil
Spessore Kapton	1.0 mil
Spessore adesivo	1.5mil
Backing	polyimide film
Adhesive type	silicone
Adhesion to steel	26 oz/inch
Tensile Strength	30 lb/inch
Elongation	70%
Dielectric Strength	7.5 kv
Lunghezza rotolo	33 mt
Colour	Amber



KAPTON DOTS

- Kapton in adesivi circolari
- 1000 adesivi per rotolo



Rev.1 05/2004 16

ELKEM S.R.L. CHEMICALS FOR PCB ASSEMBLING

Strada Banchette,1 10090 Rosta (TO) ITALY • T:+39 011 9540103/ 9542716 • F: +39 011 9597182 •



SPLICING KITS

- Splicing tapes (singoli e doppi)
- Clips
- Tools



1. Cut off the ends of the belts in the perforated holes.



2. Remove the cover foil of the SMT Double Splice tape.



3. Stick together both belts by pushing the nipples into the perforation. Press the adhesive tape on to the top side.



4. Fold down the base material in its material and press the adhesive tape to the underside. Finally, the clear plastic carrier is removed from the tape joint and discarded.

Rev.1 05/2004 17

ELKEM S.R.L. CHEMICALS FOR PCB ASSEMBLING

Strada Banchette,1 10090 Rosta (TO) ITALY • T:+39 011 9540103/ 9542716 • F: +39 011 9597182 •



Moduli di lavaggio stencil VSCM

- Efficiente
- Assenza di parti elettriche → possibilità di utilizzo di tutti le tipologie di solventi.
- Costruzione in acciaio/polipropilene
- Per stencil fino a 740 x 740 mm



SYSTEMS

VSCM - Highly efficient, economical unit for complete removal of solder paste and glue from stencil frames and screens.

- Highly effective air agitation module
- Air driven pump and filter
- Constructed from 12mm polypropylene
- Can be configured to accommodate screens and frames
- Range of sizes available up to 740 x 740mm
- Cycle-time 2-4 minutes
- Pumped chemical drain facility
- Wide range of suitable cleaning solvents
- Low maintenance

Rev.1 05/2004 18

ELKEM S.R.L. CHEMICALS FOR PCB ASSEMBLING

Strada Banchette,1 10090 Rosta (TO) ITALY • T:+39 011 9540103/ 9542716 • F: +39 011 9597182 •